

Title (en)
Resin for electrical insulation

Title (de)
Vergussmassen für die Herstellung von elektrischen Isolierungen

Title (fr)
Résine pour isolation électrique

Publication
EP 1168372 A1 20020102 (DE)

Application
EP 00810540 A 20000620

Priority
EP 00810540 A 20000620

Abstract (en)
Liquid or semi-solid casting composition for producing self-healing electrical insulation comprises an encapsulated hydrophobizing compound (I) dispersed in a polymeric resin matrix.

Abstract (de)
Flüssige oder pastöse Vergussmasse auf der Basis eines polymeren Matrixharzes oder eines Gemisches solcher Harze, für die Herstellung von selbstheilenden elektrischen Isolierungen, wobei diese Vergussmasse in gleichmässiger Verteilung eine ausgewählte hydrophobierend wirkende Verbindung oder ein Gemisch solcher Verbindungen in verkapselter Form enthält. Die Vergussmasse stellt ein duroplastisch härtbares Giessharzsystem dar, vorzugsweise auf der Basis eines duroplastisch härtbaren Polykondensats, eines duroplastisch härtbaren Polyadduktes und/oder einer Mischform derselben.

IPC 1-7
H01B 3/30

IPC 8 full level
C08K 3/22 (2006.01); **C08K 3/26** (2006.01); **C08K 3/36** (2006.01); **C08K 9/06** (2006.01); **C08L 101/00** (2006.01); **H01B 3/30** (2006.01); **H01B 3/36** (2006.01); **H01B 3/38** (2006.01); **H01B 3/40** (2006.01); **H01B 3/42** (2006.01); **H01B 17/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)
H01B 3/30 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] DE 1570922 A1 19700319 - MINNESOTA MINING & MFG
- [X] DE 1590958 A1 19700506 - VER DRAHT & KABELWERKE AG
- [A] US 5212218 A 19930518 - RINEHART WILLIAM M [US]
- [DA] US 5306747 A 19940426 - ITO HIROMI [JP], et al
- [DA] US 4537803 A 19850827 - DAKIN THOMAS W [US], et al
- [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 260 (C - 254) 29 November 1984 (1984-11-29)

Cited by
EP3249659A1; EP2624258A1; EP3648117A1; US7612152B2; US7569625B2; US7723405B2; WO2017202550A1; WO2007143475A1; WO2013117373A1

Designated contracting state (EPC)
CH DE FR GB LI

DOCDB simple family (publication)
EP 1168372 A1 20020102; EP 1168372 B1 20061004; CA 2350369 A1 20011220; CA 2350369 C 20090818; DE 50013562 D1 20061116; JP 2002075056 A 20020315; US 2002007959 A1 20020124; US 6548763 B2 20030415

DOCDB simple family (application)
EP 00810540 A 20000620; CA 2350369 A 20010613; DE 50013562 T 20000620; JP 2001185372 A 20010619; US 88401901 A 20010620